

JPCA 2026
Show
第55回国際電子回路産業展

JEIP 2026
マイクロエレクトロニクスショー
第40回 最先端実装技術・パッケージング展

JISSO PROTEC 2026
第27回 実装プロセステクノロジー展

AI Device Expo
AI デバイス展

WIRE Japan Show 2026
～装置と装置をつなぐ～
電気・光伝送技術展

Electronics Component & Unit Show
JEPC 全国電子部品流通連合会
東京都電機卸商業協同組合

E-Textile/Wearable
イーテキスタイル/ウェアラブル展

半導体産業展

OSAT SOLUTION SHOW



2026.6.10→12 Wed. Fri. 東京ビッグサイト東展示棟
Tokyo Big Sight, East Exhibition Halls

電子機器2026 トータルソリューション展

The Total Solution Exhibition for Electronic Equipment 2026

出展の
ご案内



展示会公式サイトへ

出展申込受付開始 2025年11月14日(金) 10:00～

主催：一般社団法人日本電子回路工業会、一般社団法人エレクトロニクス実装学会、
一般社団法人日本ロボット工業会
共催：電子デバイス産業新聞[(株)産業タイムズ社]、電線新聞[(株)工業通信]、
全国電子部品流通連合会/東京都電機卸商業協同組合、(株)イノベント、
一般社団法人日本OSAT連合会

後援(予定)：経済産業省

海外協力：世界電子回路業界団体協議会(WECC)加盟団体
中国電子回路行业协会(CPCA)、欧州電子回路協会(EIPC)、インド電子工業会(ELCINA)、
香港線路板協会(HKPCA)、米国電子回路協会(IPC)、インド電子回路工業会(IPCA)、
韓国電子回路産業協会(KPCA)、タイ電子回路工業会(THPCA)、
台湾線路板協会(TPCA)

Korea Packaging Integration Association(KPIA)

2025/10/24版

エレクトロニクスの機能を具現化する 全てがココにある!!

2026年展のテーマは「テクノロジーのてんこもり！—半導体から電子機器まで—」

新たに「半導体産業展」「OSAT Solution Show」が加わり、電子回路基板、実装、装置、プロセス、電子部品を誇る400社以上(予定)がテクノロジーの粋をてんこもりに発信！世界最先端の技術と出会う絶好の機会を提供します。

開催概要

会期 2026年6月10日(水)～12日(金) 午前10時～午後5時

会場 東京ビッグサイト 東展示棟

本部事務局 一般社団法人 日本電子回路工業会 (JPCA)

入場料 1,000円(税込) ※WEB登録で無料

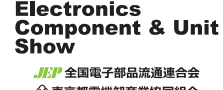
運営事務局 株式会社昭栄美術

最先端のアプリケーションに関する企画を多数開催

電子回路基板、実装、関連装置、材料／プロセス、自動運転向け高速伝送技術、EV向け大電流技術、アドバンスドパッケージング技術、パワー半導体・ガラス基板向け材料／プロセス技術、気候変動対策に寄与する低エミッション技術、E-Textile/Wearable技術、等

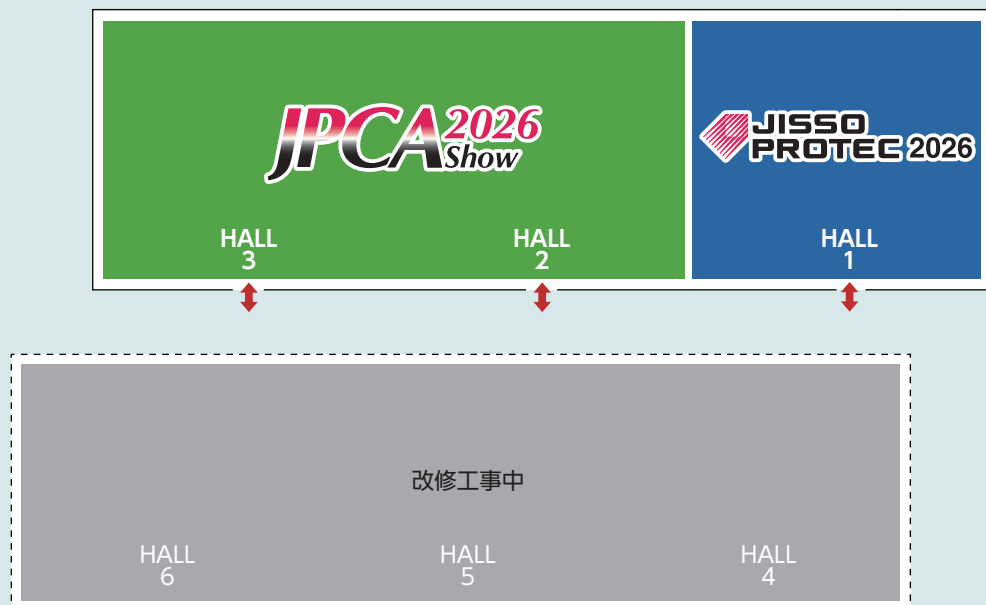
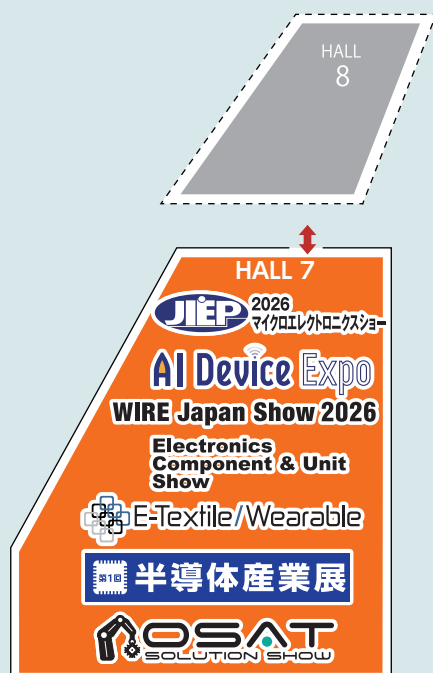
構成展示会・出展対象

電子回路技術	高密度実装技術	電子部品実装技術
 JPCA 2026 Show 第55回国際電子回路産業展 ●プリント配線板技術展 電子回路基板に関する製品・技術全般(設計・シミュレーション、信頼性・検査、基板材料、機能・プロセス材料、製造装置、関連システム、等) ●半導体パッケージング・部品内蔵技術展 モジュール基板/モジュール基板実装/部品内蔵基板・部品内蔵に関する製品・技術全般(設計・シミュレーション、信頼性・検査、基板材料、機能・プロセス材料、製造装置、関連システム、等) ●フレキシブルプリント配線板製品出展エリア フレキシブルプリント配線板に関する製品・技術全般(設計・シミュレーション、信頼性・検査、基板材料、機能・プロセス材料、製造装置、関連システム、等) ●機器・半導体受託生産システム展 EMS・ODM及び半導体の受託生産に関するサービス・技術全般(設計・シミュレーション、信頼性・検査、材料、機能・プロセス材料、製造装置、関連システム、等) 主催：一般社団法人日本電子回路工業会	 JIEP 2026 マイクロエレクトロニクスショー 第40回 最先端実装技術・パッケージング展 実装・電子技術に関する技術全般 (材料/回路・実装設計/高速高周波/電磁特性/電子部品・実装/光回路実装/環境調和型実装/半導体パッケージ/マイクロメカトロニクス実装技術/各種関連製造装置、等) 主催：一般社団法人エレクトロニクス実装学会	 JISSO PROTEC 2026 第27回 実装プロセステクノロジー展 ■電子部品実装機および関連機器・システム：電子部品装着機(マウンタ)、電子部品挿入機(インサータ)、クリームはんだ印刷機、はんだ付け装置(リフローオープン)、ディスペンサ ■実装関連機器・システム：搬送システム、AGV、自動倉庫、テーピングマシン・材料、バルクフィーダ・その他フィーダ、自動組立装置、レーザーマーキング装置、洗浄装置・洗浄剤 ■半導体実装機・システム：ボンディング装置、フリップチップ実装システム、COBシステム ■産業用ロボット：ハンドリングロボット、組立ロボット、搬送ロボット、AMR ■検査・試験装置：基板外観検査装置、半導体製造関連検査・測定装置 ■実装設計システム：設計ツール生産最適化ソフトウェア、実装プログラミング装置 ■実装デバイス・部品および関連材料 ■実装デバイス包装材料 ■実装接合システム・はんだ/接合材料 ■高周波対応装置・部品・材料 ■環境関連装置・材料 主催：一般社団法人日本ロボット工業会

AIデバイス	電気・光伝送技術	半導体・電子部品
 AI Device Expo AIデバイス展 スマートデバイス、スマートホームデバイス、ウェアラブルデバイス、ロボティクス用AIデバイス、産業用ロボット向けAIデバイス、自動運転技術、AIソフトウェアとプラットフォーム、バーチャルアシスタント、教育向けAI、医療AI、セキュリティAI、データ分析ツール、等 共催：一般社団法人日本電子回路工業会 電子デバイス産業新聞((株)産業タイムズ社)	 WIRE Japan Show 2026 電気・光伝送技術展 ワイヤー・ケーブル等を用いる伝送技術全般(産業用機器/電線・ケーブル及びコネクタ/電線加工機/配線用部材/ワイヤーハーネス/電線・ケーブル用計測器/各種装置/検査技術/装置間(M2M)伝送/光伝送等) 共催：一般社団法人日本電子回路工業会 電線新聞((株)工業通信)	 Electronics Component & Unit Show 全国電子部品流通連合会 東京都電機卸商業協同組合 半導体・電子部品等を用いたソリューション技術全般(半導体/電子デバイス/センサー/機構部品/FA制御機器/計測器/電源/ IoT・M2Mソリューション/もの作りソリューション・システム、等) 共催：一般社団法人日本電子回路工業会 全国電子部品流通連合会 東京都電機卸商業協同組合

高機能テキスタイル	半導体	半導体後工程
 E-Textile/Wearable イーテキスタイル/ウェアラブル展 電子技術と繊維・衣料が融合するイーテキスタイル(スマートテキスタイル/ストレッチャブル技術/ウェアラブル技術)に関する技術全般(繊維素材・材料/導電性素材・材料/編・織技術/プリント・マーキング技術/フィルム/センサー/信頼性検査/関連装置・システム、等) 主催：一般社団法人日本電子回路工業会	 半導体産業展 半導体設計サービス/ツール/設計受託、半導体製造装置/設備/ソフトウェア、半導体製造用部品/材料、半導体検査・試験・測定・分析装置/サービス、半導体工場用設備/備品、半導体業界向け人材派遣/物流サービス、その他半導体関連製品/サービス ※半導体産業展にご出展をご希望の場合は、半導体産業展ウェブサイトよりお問合せください。 共催：一般社団法人日本電子回路工業会 (株)イノベント	 OSAT SOLUTION SHOW 半導体後工程に関する技術・材料・装置全般(パッケージ材料、アセンブリ設備、ウェハレベルパッケージ、ファンアウト型パッケージ(FO-WLP、FO-PLP)、3D/2.5D実装、チップレット、PLP、テストシステム、ハンドリング設備、パッケージ設計ツール、シミュレーター、等) 半導体後工程に関する商社、団体、他 共催：一般社団法人日本電子回路工業会 一般社団法人日本OSAT連合会

展示会レイアウト案



2025年展実績

会場

東京ビッグサイト 東展示棟 4～7ホール

出展規模

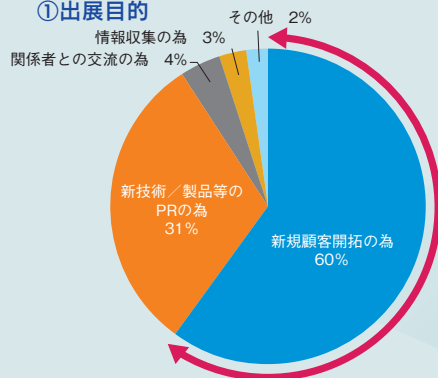
442社 / 1,197小間

来場者数

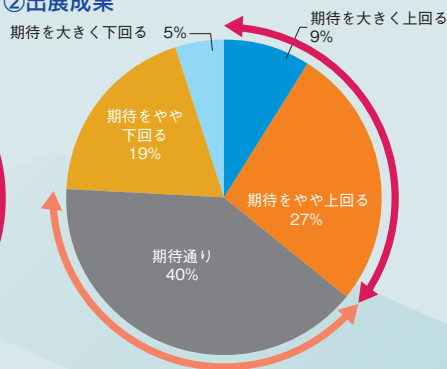
49,760名

● 出展者アンケート

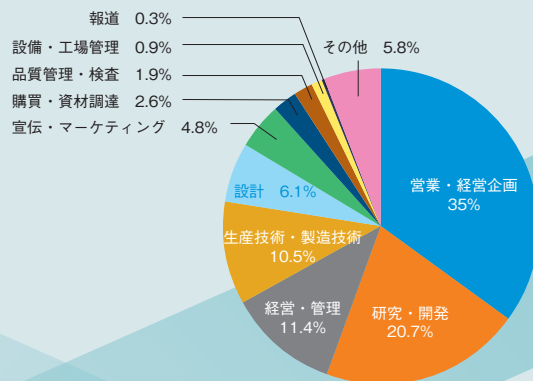
① 出展目的



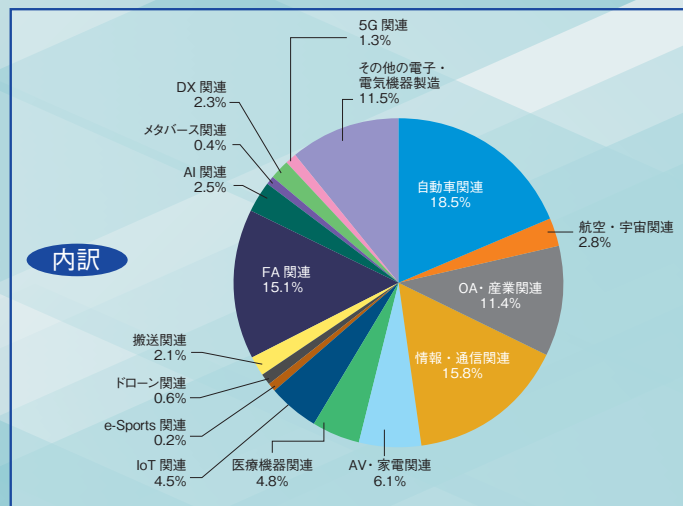
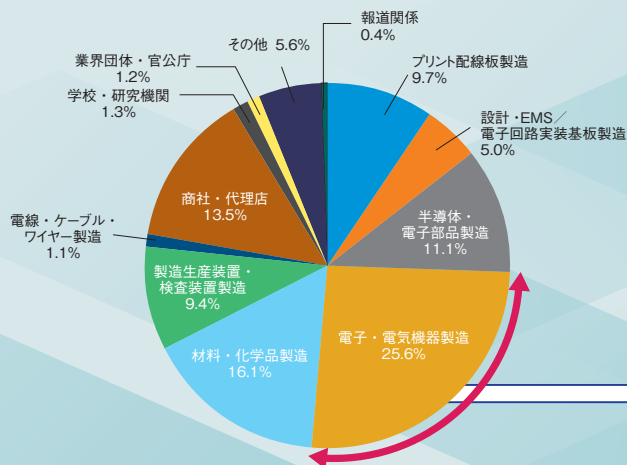
② 出展成果



● 来場者職種分類



● 来場者業種分類



内訳

自動車関連をはじめ、情報・通信関連やFA関連など、製造業の最前線で活躍するキーパーソンが多数来場！
技術提案・商談が活発に行われ、新たなビジネスチャンスの創出につながる場として高い評価を得た。

出展料金

区 分		1小間 / 9m ²
一 般		498,300円 (税込)
会員企業*1	通常	424,600円 (税込)
	早期	398,200円 (税込)
	20小間以上	372,900円 (税込)

*1 対象：JPCA会員／JIEP正会員・賛助会員／JARA正会員・賛助法人会員／JEP・TEP正会員／J-OSAT正会員・賛助会員
※1小間のサイズは、3m×3m=9m²です。
※小間設営・装飾費、電気・給排水、小間内清掃費、廃棄物処理費などの工事費および使用料は含まれていません。

出展申込 (2025年11月14日 (金) 10:00～より開始)

展示会ウェブサイトよりオンラインでお申込みください。(www.jpccashow.com)
貴社の出展製品・技術・サービスに応じて、ご出展構成展をお選びいただき、必ず、「出展規約」をご確認ください。
専用の出展申込書が用意されている展示会については、当該の出展規約が適用されます。
出展申込書を受理後、請求書を発行しますので、記載の期日までにお振込みをお願いします(原則会期前振込)。
半導体産業展にご出展をご希望の場合は、半導体産業展ウェブサイトよりお問合せください。

申込締切

早期申込締切日 (対象：会員企業)	2026年2月13日 (金)
最終申込締切	2026年2月27日 (金)

※早期料金・対象については出展料の欄をご確認ください。
※予定の小間数に達した場合、締切らせていただきますことを予めご了承ください。

取消料

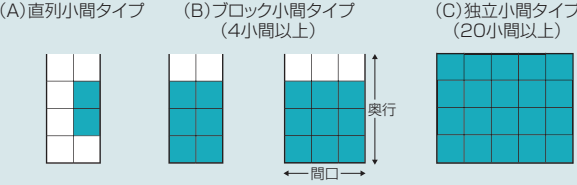
出展申込者の都合により出展を取り消す場合(全てまたは一部)下記の通り取消料を申し受けます。

書面による取消通知を受理した日	取消料
～2月27日 (金)	小間料金の 30%
2月28日 (土)～3月31日 (火)	小間料金の 50%
4月1日 (水)～4月30日 (木)	小間料金の 70%
5月1日 (金)～	小間料金の100%

開催までのスケジュール

2025年11月	2026年2月	3月	4月	5月	6月
▲ 11月14日(金) 10:00～ 出展申込受付開始	▲ 2月13日(金) 出展早期申込締切 (対象：会員企業) ▲ 2月27日(金) 出展最終申込締切	▲ 3月中旬 出展者説明会開催 出展マニュアルの公開 ▲ 3月下旬 小間位置選択会開催	▲ 4月中旬 招待状発送 来場登録開始		▲ 6月8日(月)～9日(火) 搬入期間 6月10日(水)～12日(金) 展示会開催 ※最終日即日撤去
← 3月中旬～随時 各種提出書類期限 →					

小間形態



※小間タイプのご希望に添いかなる場合もありますので、予めご了承ください。

小間位置の決定

小間位置選択会(2026年3月下旬開催予定)にて小間位置を決定いたします。
原則、同一展示会における同一申込小間数、小間形態、機能別展示会技術テーマ等を考慮した展示会レイアウトに基づき、出展申込順で選択順位を決定します。
※詳細は出展規約をご確認ください。

出展者サポートプログラム

有料・オプション

来場者データ取得サービス、各種広告プラン等出展の効果を高めるプログラムをご用意します。
※詳細は別途出展者説明会(2026年3月中旬開催予定)でご案内します。

パッケージブースプランのご案内

有料・オプション

●1小間ベーシックプラン
価格(予定)：¥121,000 (税込)
最低限必要なブース造作、電源、カーペットなどが付属したプランです。詳細は出展者説明会(2026年3月中旬開催予定)にて配布する資料をご確認ください。



お問い合わせ・資料請求受付

